

5223008-2 ✓ 有效

Z-PACK | Z-PACK Future Bus+

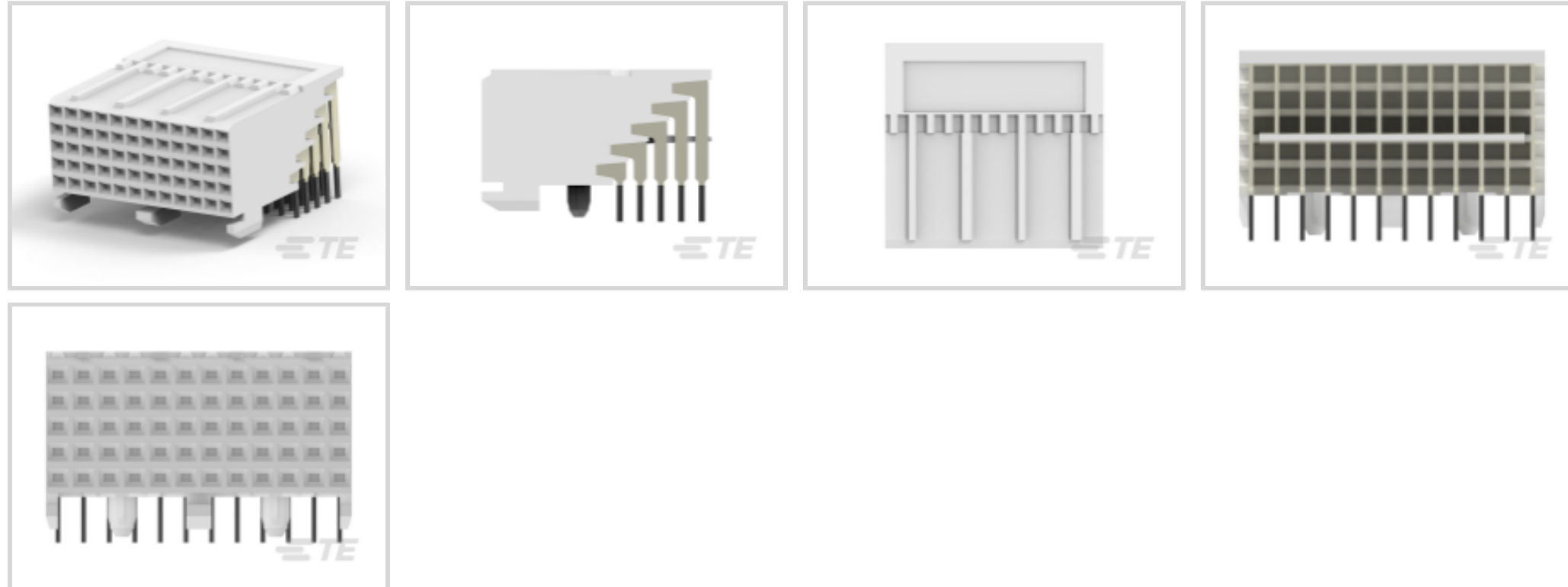
TE 内部编号 5223008-2

Backplane Connector Housings, Board-to-Board, 60 Position, 5 Row, 12 Column, Housing for Female Terminals, Sealable, Z-PACK Future Bus+

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 背板连接器壳体



连接器系统: 板对板

位数: 60

行间距: 2 mm

行数: 5

列数: 12

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

位数	60
行数	5
列数	12

### 接触件特性

端子额定电流 (最大值)	1 A
--------------	-----

### 机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

### 壳体特性

--	--

中心线 (间距)	2 mm
----------	------

### 尺寸

行间距	2 mm
-----	------

### 使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C
--------	--------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 产品合规性

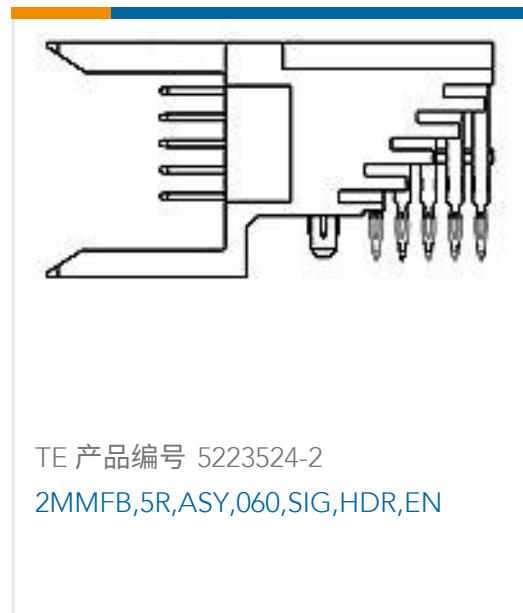
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件

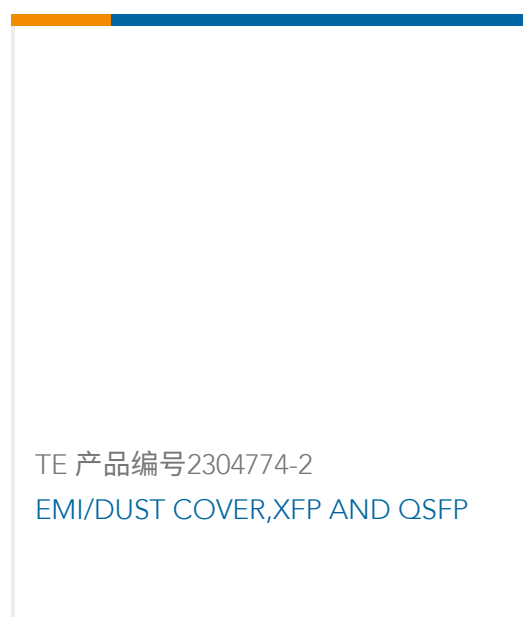


### 该系列中的其他产品 | Z-PACK Future Bus+



### 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[FB-5R,ASY,060,SIG,REC,EN,3.55](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5223008-2\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5223008-2\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5223008-2\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本

### 机构认证

[UL 报告](#)

英文版本